

Manufacturing



Manual electroless Tin plating equipment

無電解 Sn めっき

～用途～

車載基板、通信基板、電子部品の内装めっきとして、採用を検討して頂いております。鉛フリー半田接合の信頼性が高く、RoHS 規制や WEEE 規制への心配も御座いません。

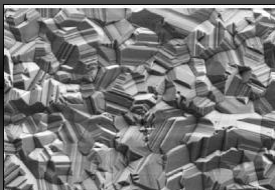
～生産能力～

◎対応製品サイズ
サイズ (MAX) 340×406mm 約 3,000 m²/Month

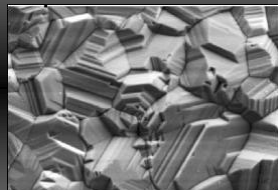
◎対応めっき仕様
無電解 Sn/Ag めっき 0.50～1.50 μm
(Ag 含有 1.0wt%)

- ◆Ag の共析により、ウイスキアの発生を抑制することが出来ます。
- ◆鉛フリー半田の窒素リフロー実装に対応可能です。

《参考》表面結晶構造～Ag の共析により平滑性が向上します。～SEM 画像より～

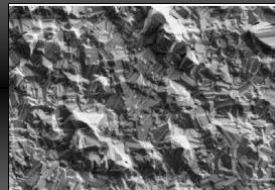


5,000 倍

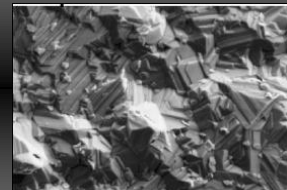


10,000 倍

置換純 Sn めっき



5,000 倍



10,000 倍

置換 Sn/Ag(1wt%)合金めっき

東電化工業 株式会社

Azuma Denka Industry Co.,Ltd. Company Profile